

2024年3月14日
TOPPAN 株式会社**TOPPAN、シンガポールに FC-BGA 基板の生産拠点を新設**
新潟工場との 2 拠点体制で、安定供給と BCP 体制を構築

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:齊藤 昌典、以下 TOPPAN)は、シンガポール共和国に高密度半導体パッケージの FC-BGA (Flip Chip Ball Grid Array) 基板の生産拠点を新設し、生産能力を拡大します。



新工場の外観(イメージ)

■ 背景と狙い

社会の急速なデジタル化に伴い、データのトラフィック量は年々増加しており、FC-BGA 基板についても需要が拡大しています。

TOPPAN は現在、FC-BGA 基板の生産拠点である新潟工場で生産能力の拡大を進めていますが、パッケージ基板の大型化に伴う製造負荷は大きく、将来の需要増に対応するためにはさらなる生産能力の拡大が必要となっています。また、BCP(Business Continuity Plan 事業継続計画)の観点からも、複数拠点での生産体制が求められています。TOPPAN は、2 拠点での生産体制を確立することで、地政学的、自然災害にかかるリスクを分散し、事業継続性を向上させるとともに、グローバルな供給体制を構築します。

なお、新工場の設立に関しては、シンガポール経済開発庁および通信用半導体大手のブロードコム
の支援を受けます。

■ 今後の展開

新工場では、新潟工場で培ってきた基板製造ノウハウや最先端の自動化ラインを導入し、世界最高水準の品質と歩留の実現を目指します。TOPPAN は、2027 年度までに FC-BGA 事業で 2022 年度対比で 2.5 倍以上の生産能力拡大を目指します。

■ 新会社・新工場の概要

商号	Advanced Substrate Technologies Pte. Ltd. (工場開設に合わせて現地法人を設立済み)
所在地	シンガポール共和国
延床面積	95,000 m ²
稼働開始時期	2026 年末
生產品目	FC-BGA 基板

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上